

**Equivalents:**

(b)(7)(C), (b)(7)(D) G-000A PNP-IP60070764-PN-IP60070764-CI DR DA W=NA DR=FPA ARSF1.G=S06&TD02/13/2001

(19) 日本国特許庁 (J P)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平6-92076

(43) 公開日 平成6年(1994)4月5日

(51) Int. Cl. <sup>4</sup>	識別記号	庁内整理番号	F 1	技術表示箇所
B 4 2 D 15/10	5 2 1	9111-2C		
G 0 6 K 19/077				
H 0 1 L 23/00				
23/50				
	A	9272-4M		
		8623-5L		
			G 0 6 K 19/00	L

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 5 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平4-246547

(22) 出願日 平成4年(1992)9月16日

(71) 出願人 000000295

神電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

(72) 発明者 井上 明信

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電気  
工業株式会社内

(72) 発明者 小林 治文

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電気  
工業株式会社内

(72) 発明者 山口 忠士

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電気  
工業株式会社内

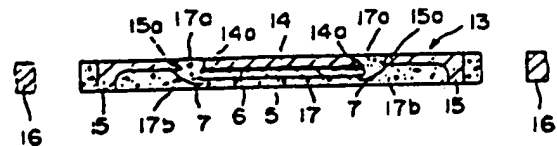
(74) 代理人 弁護士 鈴木 敏明

(54) 【発明の名称】 ICカードモジュール用リードフレーム形状

(57) 【要約】

【目的】 ICカードに搭載される、読み出し/書き込み等の機能を持つモジュールのリードフレーム形状において、リードフレームとモールド樹脂との密着力を向上させて、モジュールの曲げに対する端子部の剥離耐力を向上させるものである。

【構成】 リードフレーム13のアイランド14および端子15において、そのアイランド端ハーフエッチング部14aおよび端子端ハーフエッチング部15aの断面形状を、モールド樹脂17aおよび17bで挟持できる傾斜形状としたものである。



本発明のリードフレームを備えたICカードモジュールの断面図

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ICカードに搭載され、読み出し／書き込み等の機能を持つモジュールのリードフレーム形状において、

リードフレームのアイランド部および、または端子部のハーフエッチング部の断面形状を、モールド樹脂にて挟持できる傾斜形状にしたことを特徴とする ICカードモジュール用リードフレーム形状。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、ICカードに搭載される読み出し／書き込み等の機能を持つモジュールのリードフレーム形状に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 図 3 は、従来のリードフレーム形状を備えた ICカードモジュールを示す平面図およびその A1-A2 断面図である。図において、1 はその詳細な構成を図 4 に示すように、例えば板厚 0.6 mm のリードフレームである。このリードフレーム 1 はアイランド 2、端子 3 および外枠 4 からなっている。5 はリードフレーム 1 のアイランド 2 の下部に、ボンディングシート 6 を介してボンディングした半導体素子、7 は端子 3 と半導体素子 5 間をワイヤボンディングしたボンディングワイヤ、8 はモールド樹脂封止金型にてモールド樹脂境界線 9 内を充填したモールド樹脂、10 はこのモールド樹脂封止金型のエジクトピンである。

【0003】 次に、上記構成のリードフレームの製造工程を図 5 (a) ~ 図 5 (c) を参照して説明したのち、ICカードモジュールの製造方法を図 3 (A) および図 3 (B) を参照して説明する。まず、図 5 (A) に示すように、リードフレーム 1 の基材 1 a の表面に、リード形状として残した部分にレジスト 11 を塗布する。そして、図 5 (B) に示すように、矢印 12 の方向からエッチングする。そして、図 5 (C) に示すように、このレジスト 11 を除去することにより、図 4 に示すリードフレーム 1 を製造することができる。そして、このリードフレーム 1 のアイランド 2 の下部に、半導体素子 5 をボンディングシート 6 を介してボンディングする。そして、この半導体素子 5 と端子 3 間をボンディングワイヤ 7 によりボンディングを行なう。そして、モールド樹脂封止金型にて、モールド樹脂境界線 9 内をモールド樹脂 6 で充填する。そして、モールド樹脂封止金型のエジクトピン 10 により金型より突き上げて、取り出したのち、仮片化し、図示せぬ IC カード上に実装するものである。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記構成のリードフレーム形状では、アイランド 2 のハーフエッチング部のアイランド形状 2 a (図 5 (C) 参照) および端子 3 のハーフエッチング部の端子形状 3 a

(図 5 (C) 参照) が R 形状になっているため、リードフレーム 1 とモールド樹脂 8 とは接着力の面で保持されている。このため、(A) モールド成形時、モールド樹脂封止金型内のエジクトピンにて突き上げる際、モールド樹脂と金型との離脱時、モールド樹脂とモールド樹脂封止金型との密着力により、モジュールを反らせ、端子部が剝離してしまうこと、(B) モジュールを IC カード上に実装したのち、折り曲げ試験により端子部が剝離し、この剝離により、ワイヤ断線、およびモジュール内へ水分が侵入し、A1 腐食などが発生するという問題点があった。

【0005】 本発明は、以上述べた端子部の剝離によるワイヤの断線および A1 腐食という問題点を除去するため、端子部の断面形状を変えることにより、端子とモールド樹脂との剝離をなくすることができる傾斜形状を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】 本発明に係る IC カードモジュール用リードフレーム形状は、そのアイランド部ハーフエッチング部および端子部ハーフエッチング部の断面形状を、モールド樹脂にて挟持できる傾斜形状にするものである。

【0007】

【作用】 本発明は、端子部の剝離能力を大幅に向上させることができる。

【0008】

【実施例】 図 1 は本発明に係る IC カードモジュール用リードフレーム形状の一実施例を備えた IC カードモジュールを示す断面図である。図において、13 はその製造工程を図 2 (A) ~ 図 2 (E) に示すリードフレームである。このリードフレーム 13 はアイランド 14、複数個の端子 15 および外枠 16 を備えている。特に、アイランド 14 のアイランド部ハーフエッチング部 14 a および端子 15 の端子部ハーフエッチング部 15 a の断面形状は、モールド樹脂 17 にて挟持できるように傾斜させて形成したものである。具体的には、アイランド部ハーフエッチング部 14 a および端子部ハーフエッチング部 15 a で形成された空間に充填されたモールド樹脂 17 a と半導体素子 5 間に充填されたモールド樹脂 17 b によってアイランド 14 および複数個の端子 15 の縁部を挟持できるように形成される。

【0009】 次に、上記構成のリードフレームの製造工程を図 2 (A) ~ 図 2 (E) を参照して説明したのち、ICカードモジュールの製造方法について説明する。まず、図 2 (A) に示すように、リードフレーム 13 の基材 13 a の両表面に、リード形状として残した部分にレジスト 18 を付ける。そして、図 2 (B) に示すように、基材 13 a の一方の表面をエッチングする。そして、図 2 (C) に示すように、基材 13 a のエッチングした部分に、レジスト 19 を付ける。そして、図 2

3

(D) に示すように、母材 13e の他の表面をエッチングする。そして、図 2 (E) に示すように、レジスト 18 および 19 を除去することにより、リードフレーム 13 を製造することができる。このようにして、アイランド端ハーフエッチング部 14e および端子端ハーフエッチング部 15e の断面形状は、モールド樹脂 17 にて挟持できるように傾斜させて形成することができる。そして、このリードフレーム 13 のアイランド 14 の下部に、半導体素子 5 をボンディングシート 6 を介してボンディングする。そして、この半導体素子 5 と端子 15 間をボンディングワイヤ 7 によりボンディングを行なう。そして、モールド樹脂封止金型にて、モールド樹脂境界線内をモールド樹脂 17 で充填する。そして、モールド樹脂封止金型のエジェクトピンにより、金型より突き上げて、取り出したのち、削片化し、図示せぬ IC カード上に実装するものである。

[0010]

【発明の効果】 以上詳細に説明したように、本発明に係る IC カードモジュール用リードフレーム形状によれば、アイランド端ハーフエッチング部および端子端ハーフエッチング部の断面形状を、モールド樹脂にて挟持できるように形成したので、端子部の剥離耐力が向上し、

4

ワイヤ断線や A 1 腐食の発生を防ぐことができ、品質を向上することができるなどの効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明に係る IC カードモジュール用リードフレーム形状の一実施例を備えた IC カードモジュールを示す断面図である。

【図 2】 図 1 の IC カードモジュール用リードフレーム形状の製造工程を示す断面図である。

【図 3】 従来の IC カードモジュールを示す平面図および断面図である。

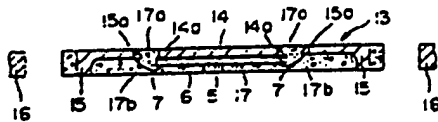
【図 4】 図 3 のリードフレームを示す平面図である。

【図 5】 図 3 のリードフレームの製造工程を示す断面図である。

【符号の説明】

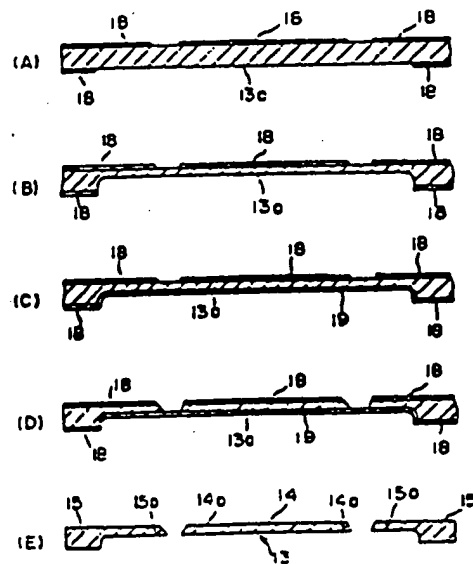
- 5 半導体素子
- 13 リードフレーム
- 14 アイランド
- 15 端子
- 16 外枠
- 17 モールド樹脂
- 18, 19 レジスト

【図 1】



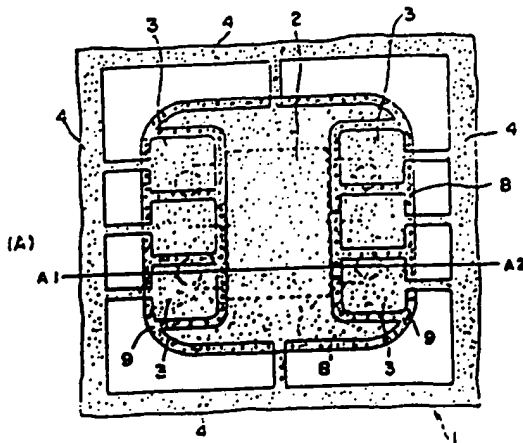
本発明のリードフレームを備えた IC カードモジュールの断面図

【図 2】



本発明のリードフレームの製造工程を示す断面図

[図3]



[図4]

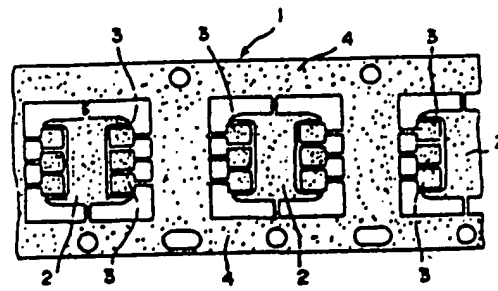
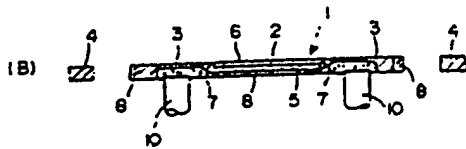


図3のV-フレームの断面図



このV-フレームの断面図

[図5]

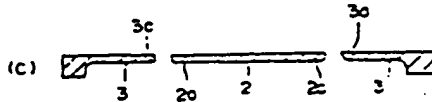
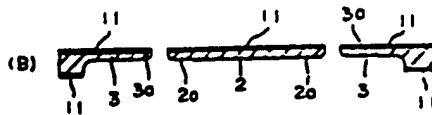
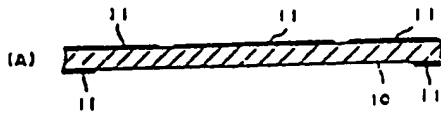


図3のV-フレームの断面図

(5)

院平6-92076

フロントページの続き

(51) Int. Cl.<sup>4</sup>  
H 01 L 23/50

識別記号 庁内整理 号 F I  
H 9272-4M

技術表示箇所

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平6-92076

(43) 公開日 平成6年(1994)4月5日

(51) Int. Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	F 1	技術表示箇所
B 4 2 D 15/10	5 2 1	9111-2C		
G 0 6 K 19/077				
H 0 1 L 23/00				
23/50		A 9272-4M		
		8623-5L		
		G 0 6 K 19/00	L	
		審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号 特願平4-246547

(22) 出願日 平成4年(1992)9月16日

(71) 出願人 000000295

神電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

(72) 発明者 井上 明徳

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電気  
工業株式会社内

(72) 発明者 小林 治文

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電気  
工業株式会社内

(72) 発明者 山口 忍士

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電気  
工業株式会社内

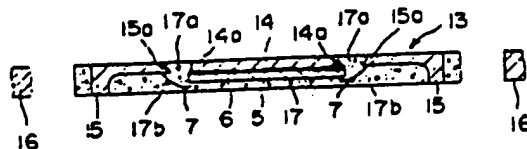
(74) 代理人 弁理士 鈴木 敏明

(54) 発明の名称 : Cカードモジュール用リードフレーム形状

(57) 要約

【目的】 ICカードに搭載される、読み出し/書き込み等の機能を持つモジュールのリードフレーム形状において、リードフレームとモールド樹脂との密着力を向上させて、モジュールの曲げに対する端子部の剥離耐力を向上させるものである。

【構成】 リードフレーム13のアイランド14および端子15において、そのアイランド端ハーフエッチング部14aおよび端子端ハーフエッチング部15aの断面形状を、モールド樹脂17aおよび17bで挟持できる傾斜形状としたものである。



本発明のリードフレームを備えたICカードモジュールの断面図

(D)に示すように、母材13aの他の位置をエッチングする。そして、図2(E)に示すように、レジスト18および19を除くことにより、リードフレーム13を製造することができる。このようにして、アイランド端ハーフエッチング部14aおよび端子端ハーフエッチング部15aの断面形状は、モールド樹脂17にて保持できるように傾斜させて形成することができる。そして、このリードフレーム13のアイランド14の下側に、半導体素子5をボンディングシート6を介してボンディングする。そして、この半導体素子5と端子15間をボンディングワイヤ7によりボンディングを行なう。そして、モールド樹脂封止金型にて、モールド樹脂境界線内をモールド樹脂17で充填する。そして、モールド樹脂封止金型のエジェクトピンにより、金型より突き上げて、取り出したのち、割片化し、図示せぬICカード上に実装するものである。

【0010】

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明に係るICカードモジュール用リードフレーム形状によれば、アイランド端ハーフエッチング部および端子端ハーフエッチング部の断面形状を、モールド樹脂にて保持できるように形成したので、端子部の耐電耐力が向上し、

ワイヤ断線やムラ腐食の発生を防ぐことができ、品質を向上することができるなどの効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るICカードモジュール用リードフレーム形状の一実施例を備えたICカードモジュールを示す断面図である。

【図2】図1のICカードモジュール用リードフレーム形状の製造工程を示す断面図である。

【図3】従来のICカードモジュールを示す平面図および断面図である。

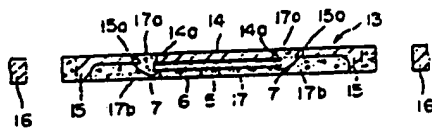
【図4】図3のリードフレームを示す平面図である。

【図5】図3のリードフレームの製造工程を示す断面図である。

【符号の説明】

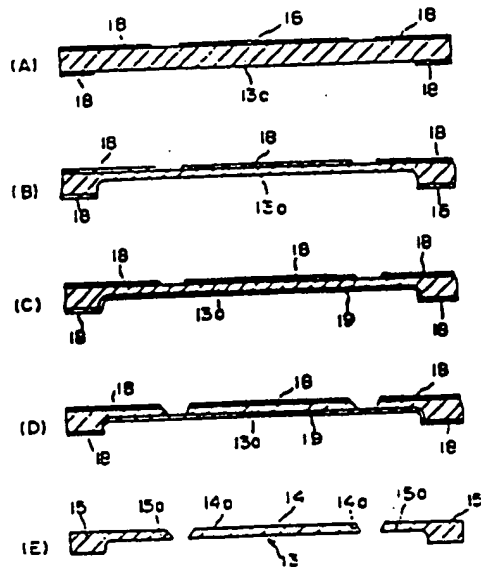
- 5 半導体素子
- 13 リードフレーム
- 14 アイランド
- 15 端子
- 16 外枠
- 17 モールド樹脂
- 18, 19 レジスト

【図1】



本発明のリードフレームを備えたICカードモジュールの断面図

【図2】



本発明のリードフレームの製造工程を示す断面図



[図3]

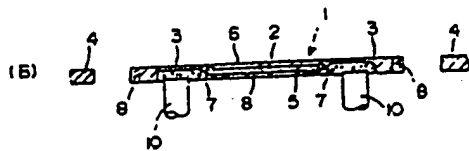
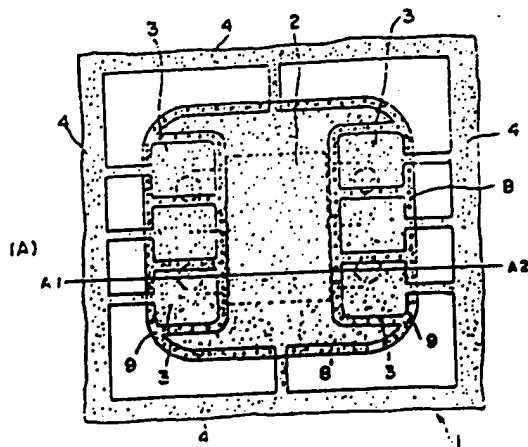


図3のV-フレームの断面図

[図5]

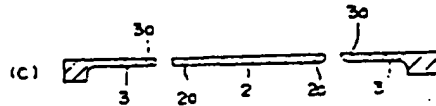
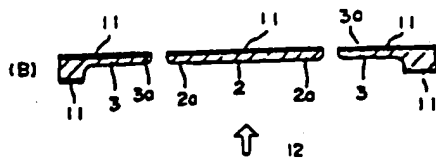
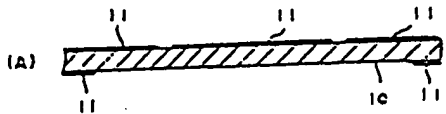


図5のV-フレームの断面図

[図4]

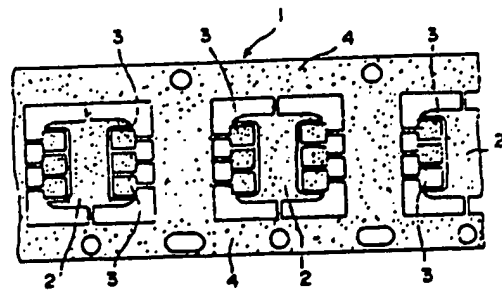


図4のV-フレームの断面図

(5)

特開平6-92076

フロントページの続き

(51) Int. Cl.<sup>4</sup>  
H01L 23/50

識別記号 庁内整理号 F1  
H 9272-4M

技術表示箇所